



台積公司董事會通過買回公司股份

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司

發佈日期：九十七年八月十二日

台灣積體電路製造股份有限公司今(12)日召開董事會，會中核准在不超過新台幣165億元(約美金5億4,200萬元)或不超過2億8,300萬股的範圍內，自集中交易市場買回公司股份並將辦理解銷。預計每股買回價格將介於新台幣42.85元與86.20元之間，預定買回期間為今年八月十三日至十月十二日之間。

台積公司發言人何麗梅副總經理表示，此次買回公司股份純粹是為了消除部分因員工分紅所產生的股權稀釋；並且與本公司和飛利浦公司先前所達成的多階段釋股方案不同，也就是說，飛利浦公司不會經由這項股份買回計劃釋出對台積公司之持股。

此外，今日董事會之其他重要決議如下：

- 一、 核准資本預算6億8,760萬美元，以擴充十二吋晶圓廠之45奈米及40奈米製程產能。
- 二、 核准資本預算1億740萬美元購買八吋晶圓廠之生產設備，用以將部分0.18微米邏輯製程產能升級為0.11微米互補金氧半導體影像感測器製程、0.11微米邏輯製程、0.13微米高壓製程及0.18微米射頻製程產能。此外，並將部分0.35微米邏輯製程產能升級為微機電製程產能。
- 三、 核准合併本公司百分之百持股之欣瑞投資有限公司。
- 四、 核准本公司民國九十七年度上半年財務報表，累計今年一至六月合併營收為新台幣1,756億1,700萬元，稅後純益則為新台幣569億1,400萬元。

#

台積公司發言人：
何麗梅
副總經理暨財務長
Tel: 03-566-4602